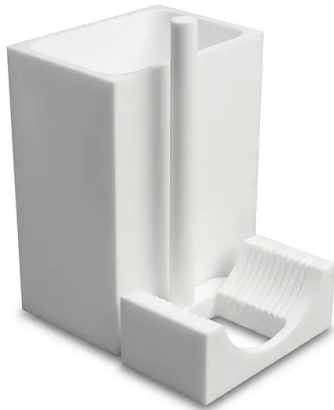


# Anpassbarer Quadratischer Ptfе-Siliziumwafer-Reinigungs-Blumenkorb Für Das Nassprozess-Ätzen Und Die Substrathandhabung In Der Halbleiterfertigung

Artikelnummer: PL-CP88



## Einführung

Hochreine quadratische PTFE-Reinigungs-Blumenkörbe für die Siliziumwafer-Verarbeitung. Dieses korrosionsbeständige Gestell gewährleistet sicheres Nassätzen und Substrathandling in der Halbleiterfertigung. Vollständig anpassbare Abmessungen und Konfigurationen sind verfügbar, um spezifische Labor- oder Industrietisch-Anforderungen zu erfüllen.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Halbleiterfertigung	Eintauchen von Siliziumwafern in RCA-Reinigungs- oder Piranha-Ätzlösungen zur Entfernung von Verunreinigungen.	Kein Risiko metallischer Kontamination
Photovoltaikzellen-Produktion	Handhabung von großformatigen Solarwafern während der Texturierungs- und Säurepolitur-Stadien.	Hoher Durchsatz und Langlebigkeit
MEMS-Bauelementeverarbeitung	Sicherer Transport empfindlicher mikro-elektromechanischer Substrate durch verschiedene Wet Benches.	Präzise Substratpositionierung
LCD/OLED-Glasreinigung	Reinigung von leitfähigen Glassubstraten (ITO/FTO) vor der Dünnschichtabscheidung.	Chemikalienbeständigkeit gegen Glasreiniger
Hochreine Laborforschung	Halten von Proben während der Spurenanalyse und aggressiver chemischer Aufschlussprozesse.	Überlegene Beständigkeit gegen korrosive Medien
Nanotechnologie-Substrate	Verarbeitung von Silicon-on-Insulator (SOI)- oder Saphir-Wafern in Forschungsumgebungen.	Schonende Handhabung spröder Materialien

Spezifikationskategorie	Parameterdetails für PL-CP88
Modellbezeichnung	PL-CP88
Primärmaterial	Hochreines Polytetrafluorethylen (PTFE)
Standardabmessungen	249mm x 249mm (Individuelle Größen auf Anfrage)
Geometrie	Quadratisches Rahmen-Blumenkorb-Design
Anpassungsoptionen	Schlitzanzahl, Schlitzbreite, Schlitztiefe, Teilung und Griffstil
Betriebstemperaturbereich	-200°C bis +260°C
Chemikalienbeständigkeit	Universell (außer geschmolzene Alkalimetalle und Hochdruck-Fluor)
Fertigungsmethode	Durchgängige Präzisions-CNC-Bearbeitung für hohtolerante Spezifikationen
Oberflächenbeschaffenheit	Glatte, nicht poröse Fluoropolymerschicht
Kompatibilität	Manuelle Tauchbäder und automatisierte Roboter-Wet-Bench-Arme